

PRESSEINFORMATION

PRESSEINFORMATION27. August 2013 || Seite 1 | 2

SKZ-Seminar »Polymerverguss in Elektrik und Elektronik« unter Leitung des Fraunhofer IFAM

Aufgrund der starken Nachfrage bietet das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen, zusammen mit dem Süddeutschen Kunststoff-Zentrum SKZ vom 7. bis 8. November 2013 im SKZ Weiterbildungs-Zentrum in Würzburg eine Neuauflage des Seminars »Polymerverguss in Elektrik und Elektronik« an. Die Veranstaltung richtet sich an Anwender, Entwicklungsingenieure und Konstrukteure sowie Verantwortliche in Produktion und Qualitätssicherung.

Das Programm des Seminars orientiert sich an den relevanten Prozessschritten des Elektronikvergusses. Es vermittelt einen praxis- und anwendungsorientierten Überblick über die aktuellen Vergussmassen, Applikationsverfahren, Vorbehandlungs- sowie Prüfmöglichkeiten und gibt zudem Hinweise zur konstruktiven Auslegung von zu vergießenden Baugruppen. Darüber hinaus dient das Seminar als Plattform zum branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch – dass hier ein großer Bedarf besteht, bewiesen die lebhaften und engagierten Diskussionen der Teilnehmer während des Auftaktseminars 2012.

Die steigende Anzahl elektronischer Baugruppen und deren Einsatz, z. B. in Kraftfahrzeugen sowie Flugzeugen, führen zu hohen Anforderungen hinsichtlich Langzeitstabilität und Funktionssicherheit. Durch Vergießen oder durch Auftrag von Schutzlacken werden die zu schützenden Bauteile durch ein Polymer komplett umschlossen, um ihre Zuverlässigkeit zu sichern. Dabei ist ein Trend zu stetig steigenden Anforderungen hinsichtlich Feuchtebeständigkeit, Temperatur, Temperaturschock sowie elektrische Isolation und Wärmeleitung deutlich zu erkennen. Es gilt, diese wachsenden Ansprüche in die Praxis umzusetzen und die End Eigenschaften der Baugruppen zuverlässig vorherzusagen.

Das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen, hat die fachliche Leitung des Seminars inne. Im Fraunhofer IFAM wurde 2011 auf Betreiben von Institutsleiter Prof. Dr. Bernd Mayer das Kompetenzfeld Vergießen von Elektro- und Elektronikkomponenten im Bereich Klebtechnik und Oberflächen etabliert. In diesem interdisziplinären Forschungs- sowie Entwicklungsbereich bündeln und bearbeiten die Wissenschaftler des Instituts die vielfältigen Anfragen aus der Industrie rund um das Thema Verguss. Insbesondere in der Planungsphase besteht nach wie vor großer Beratungsbedarf hinsichtlich Materialauswahl und einem vergussgerechten Design der zu schützenden Bauteile.

Redaktion

Dipl.-Ing. Anne-Grete Becker | Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM | Klebtechnik und Oberflächen | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | Telefon +49 421 2246-400 | Wiener Straße 12 | 28359 Bremen | www.ifam.fraunhofer.de | anne-grete.becker@ifam.fraunhofer.de |

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR FERTIGUNGSTECHNIK UND ANGEWANDTE MATERIALFORSCHUNG IFAM

Das Fraunhofer IFAM greift bei der Bearbeitung dieser Fragestellungen auf die langjährigen Erfahrungen aus dem Bereich der Klebtechnik zurück, da hier sowohl bezüglich des Prozesses als auch hinsichtlich der verwendeten, meist reaktiven Materialien große Ähnlichkeiten zum Vergießen bestehen.

PRESSEINFORMATION

27. August 2013 || Seite 2 | 2

Im Rahmen dieser Aktivitäten wurde Ende 2012 erstmals zusammen mit dem Süddeutschen Kunststoff-Zentrum SKZ das Seminar »Polymerverguss in Elektrik und Elektronik« mit großem Erfolg und Zuspruch seitens der Teilnehmer durchgeführt. Die nun folgende Neuauflage vom 7. bis 8. November 2013 in Würzburg setzt Bewährtes fort und ergänzt wichtige Neuerungen zu dieser Thematik.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung und der Anmeldung finden Sie im beigefügten Programm oder unter

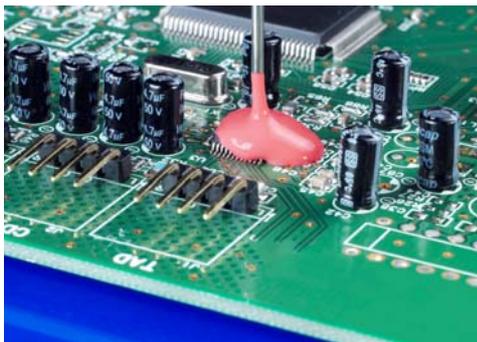
www.ifam.fraunhofer.de/de/Aus_Weiter_Bildung/Weiterbildung/Weiterbildung.html
www.skz.de/de/weiterbildung/seminare/lehr_/Polymerverguss_in_Elektrik_und_Elektronik/index.html?detID=5834

Foto

© Fraunhofer IFAM, Veröffentlichung frei in Verbindung mit Berichterstattung über diese Presseinformation.

Download unter:

www.ifam.fraunhofer.de/de/Presse/Downloads.html



Bildunterschrift

Vergießen eines elektronischen Bauteils (© Fraunhofer IFAM).